

南臺科技大學 107 學年度第 2 學期課程資訊

課程代碼	30D1CH01
課程中文名稱	電路板分析與拆錫實務
課程英文名稱	Principle of Circuit Board Analytics with Soldering and Unsoldering
學分數	2.0
必選修	管制選修
開課班級	四技醫電四甲 四技電資四甲四技控晶四甲四技控晶四乙四技網通四甲四技晶片 四甲四技晶片 四乙四技系統四甲四技微電四甲
任課教師	謝文哲
上課教室(時間)	週五第 5 節(J405) 週五第 6 節(J405) 週五第 7 節(J405) 週五第 8 節(J405)
課程時數	4
實習時數	2
授課語言 1	華語
授課語言 2	
輔導考照 1	
輔導考照 2	
課程概述	培養學生電路板分析與拆錫相關技術及知識，為業界實用之技能。
先修科目或預備能力	
課程學習目標與核心能力之對應	<p>※編號，中文課程學習目標，英文課程學習目標，對應系指標</p> <p>-----</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.了解電路板分析與拆焊相關技術。 ,-- ,1 專業技能 2.能分析電路板故障原因，排除故障問題。 ,-- ,2 工程實務 3.建立後續學習各種電路板分析與拆焊技巧之能力。 ,-- ,5 終身學習 4.學習電路維修能力，避免失誤。 ,-- ,6 熱誠抗壓 5.透過分組討論與實作，學習電路板分析與拆焊技巧。 ,-- ,8 專案管理
中文課程大綱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 電路圖與電路板介面 2. 零件佈置 3. 電路板信號分析

	4. 銀絲線佈局銲接 5. 插件式元件基礎拆/銲接 6. 表面黏著元件基礎拆/銲接 7. 電子元件電路板實際操作 8. 成品電路板功能測試
英/日文課程大綱	1. Circuit diagram and board interface 2. Parts layout 3. Printed circuit board signal analysis 4. Silver plated wire layout welding 5. Plug-in component base removal / welding 6. Surface adhesive component foundation removal / welding 7. Electronic component circuit board operation 8. Finished circuit board function test
課程進度表	電路圖與電路板介面(第 1~2 週) 零件佈置(第 3~4 週) 電路板信號分析(第 5~6 週) 銀絲線佈局銲接(第 7~8 週) 銀絲線佈局銲接(第 9~11 週) 插件式元件基礎拆/銲接(第 12~13 週) 表面黏著元件基礎拆/銲接(第 14~15 週) 電子元件電路板實際操作(第 16~17 週) 成品電路板功能測試(第 18 週)
教學方式與評量方法	※課程學習目標，教學方式，評量方式 ----- 了解電路板分析與拆焊相關技術。 ， 課堂講授， 實作 能分析電路板故障原因，排除故障問題。 ， 實作演練， 實作 建立後續學習各 種電路板分析與 拆焊技巧之能 力。 ， 實作演練， 實作 學習電路維修能 力，避免失誤。 ， 實作演練， 實作 透過分組討論與實作，學習電路板分析與拆焊技巧。 ， 實作演練， 實作
指定用書	書名： 作者： 書局： 年份：

	ISBN： 版本：
參考書籍	放置於 Flip 數位學習網，請自行下載
教學軟體	
課程規範	